

1. Record Nr.	UNICAMPANIASUN0126018
Titolo	Die-Attach Materials for High Temperature Applications in Microelectronics Packaging : Materials, Processes, Equipment, and Reliability / Kim S. Siow editor
Pubbl/distr/stampa	XX, 279 p., : ill. ; 24 cm
Edizione	[Cham : Springer, 2019]
Descrizione fisica	Pubblicazione in formato elettronico
Disciplina	621.36 620.11 620.1 658.4 669 621.381
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia